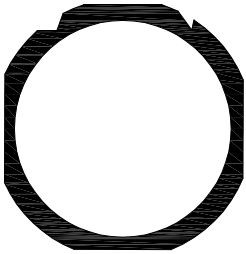

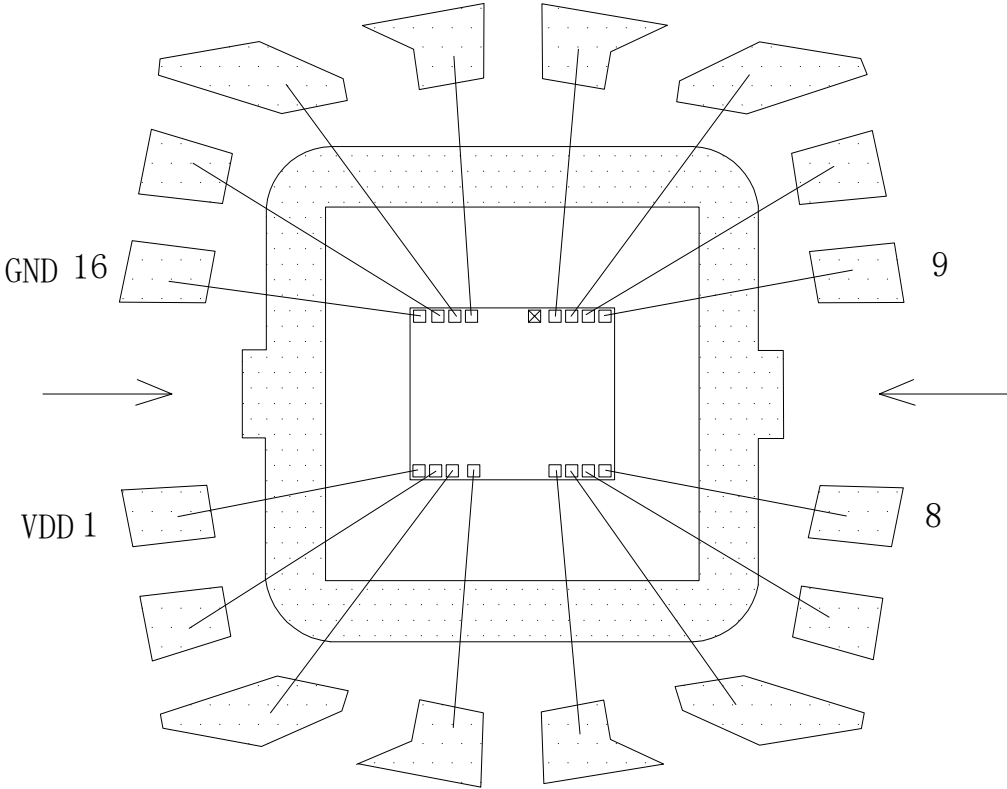


江苏芯丰集成电路封装压焊图		图号:314BD018	版本	A.0
贴片方向（芯片与片环方向示意图） 	框架传输进料方向 第一个孔为椭圆孔 			
		备注及特殊要求（Remark&Special Instruction） 框架到芯片最高点的线弧高度<600um 居中装片		



请仔细核对焊线位置，以及材料选择。 如无误  
请签字回传，谢谢！ 客户回签：

顶针		点胶方式		如选择UV膜 请确认 产品是否可以照 射紫外线， 如不能请讲明	<input type="checkbox"/> UV膜 <input checked="" type="checkbox"/> 蓝膜 <input type="checkbox"/> DAF膜	风险监控： 低风险					
单顶针	多顶针	点胶	画胶								
	/		/								
产品型号 (Product Type)		HS0986D		线材直径 (Wire Diameter)		银合金线0.8mil		芯片减薄厚度 Chip thinning thickness		300±10um	
芯片名称 (Die Name)		HS0986D		压焊点尺寸 (Pad Opening)		50X50um		装片胶 Epoxy (二选一)		首选	9246LB5(导电胶)
芯片尺寸 (Die Size)		0.706X0.84mm		最小压焊间距 (Min Pitch)		68.52um				备选	/
封装形式 (Package Type)		SOP16L(9.9×3.9×1.4 e=1.27)		先焊线 (Wire Bond Start)		PIN16		塑封料 Molding Compound (二选一)		首选	EMC-GR710F GN
引线框 (Lead Frame)		SOP16L(12R)(80×80) -H		焊线总数 (Quantity of Wire)		16				备选	/
L/F电镀方式 (L/F Plating Type)		雾锡		最长线长/总线长 (Length of Wire)		1.39/17.957mm		CUP/BOAC		<input checked="" type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> NO
晶圆尺寸/切割方式 (Wafer Size/Cutting Mode)		12寸/刀片开槽 +刀片切割		顶层铝厚度 (Top aluminum thickness)		1.2um(3层)		RF 芯片		<input type="checkbox"/> YES	<input checked="" type="checkbox"/> NO
吸嘴 (suction nozzle)		RT-020		切割道(Cutting Way)		60um		LOW-K芯片		<input type="checkbox"/> YES	<input checked="" type="checkbox"/> NO
拟制 Prepared by		顾馨 2024.8.26		审核 Checked by		李佳欣		批准 Approved by		周建军	